证券代码:600703　　股票简称:三安光电　　编号:临2015-015

三安光电股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案

二〇一五年三月

公司声明

三安光电股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺:本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

三安光电股份有限公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

中国证券监督管理委员会,其他政府部门对本次非公开发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

特别提示

1、三安光电股份有限公司本次非公开发行股票的相关事项已经第八届董事会第十三次会议决议通过。

2、公司高度重视对股东的回报,公司2014年4月22日第七届董事会第四十五次会议、2014年5月13日年度股东大会审议并通过了《修改<公司章程>第一百五十五条内容的议案》,公司2015年3月23日第八届董事会第十三次会议《<公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案》,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》进一步完善了分红管理制度和分红决策监督机制,在公司章程中明确规定现金分红政策,分红决策机制及分红监督约束机制等。

近三年来,公司在保证业务发展需要的基础上,严格按照《公司章程》和中国证监会的相关规定,坚持现金分红为主的利润分配政策,2011年到2013年累计现金分红金额(含税)为104,108.49万元,占三年实现的年均可分配利润的比例为112.26%;公司2015年3月23日第八届董事会第十三次会议通过2014年年度利润分配预案:拟以2014年年末总股本2,393,084,883股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),派发现金股利总额为478,616,976.60元,剩余未分配利润结转下一年度;该预案需经股东大会批准后实施。2014年拟现金分红金额占当年可分配利润的比例为32.73%。

为抓住行业发展良机,跻身行业世界领先企业,根据公司发展战略的需要,报告期内公司将留存的未分配利润用于公司主营业务,并促进公司业务快速发展,公司营业收入由2012年度的336,315.82万元快速增加到2014年度的457,966.51万元,年均复合增长率16.69%。公司历来注重股东回报和自身发展的平衡。在合理回报股东的情况下,公司上述未分配利润的使用,有效降低了公司的筹资成本,同时增加了公司财务的稳健性。

3、本次非公开发行对象为包括公司实际控制人林秀成先生控制的三安集团在内、不超过10名的特定对象。除三安集团之外,其他发行对象须为符合证监会规定的投资者,包括证券投资基金管理公司(以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象)、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司(以其自有资金)、QFII、主承销商自主推荐的具有较高定价能力和长期投资意向的机构投资者,以及符合中国证监会规定其他法人、自然人或者其他合法投资组织;其他具体发行对象将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后,由董事会和保荐人(主承销商)根据发行对象申购报价情况,按照价格优先原则确定。特定对象均以现金认购。发行对象应符合法律、法规规定的条件。

公司已与三安集团签订了《附条件生效股份认购合同》,三安集团拟以现金方式认购本次非公开发行股票总数的10%。

4、本次发行后,公司实际控制人不会发生变化。本次非公开发行股票数量不超过23,522万股(含23,522万股)。在该范围内,具体发行数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人(主承销商)协商确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行数量和发行底价进行相应调整。

5、发行价格不低于三安光电第八届董事会第十三次会议决议公告日2015年3月24日(定价基准日)前20个交易日公司股票均价的90%,即不低于16.58元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后,由董事会和保荐人(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行数量和发行底价进行相应调整。

三安集团承诺按其他认购对象竞价确定的发行价格认购公司本次非公开发行的股票。

6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过390,000万元,投入厦门光电产业化(二期)项目和通讯微电子器件(一期)项目。若本次发行募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额,不足部分由公司自筹解决。为把握市场机遇,尽快完成募集资金投资项目,在本次募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金、银行贷款等自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

7、本次发行尚需经过股东大会审议批准并经中国证监会核准方可实施。

释　义

除非文中另有所指,下列词语具有如下涵义:

公司、上市公司、三安光电	指	三安光电股份有限公司
三安电子	指	厦门三安电子有限公司
三安集团	指	福建三安集团有限公司
厦门集成电路	指	厦门市三安集成电路有限公司
厦门三安光电	指	厦门三安光电有限公司,三安光电的全资子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
LED	指	Lighting Emitting Diode,即发光二极管,是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光
外延片	指	在一块加热至适当温度的衬底基片上,气态物质(In,Ga,Al,P)有控制的输送到衬底表面,生长出的特定单晶薄膜
芯片	指	LED中实现电-光转化功能的核心单元,由LED外延片经特定工艺加工而成
衬底	指	用于LED外延片生长的基础材料,主要有蓝宝石(Al2O3)、碳化硅(SiC)、砷化镓(GaAs)等
半导体	指	英文"semiconductor",是指常温下导电性能介于导体(conductor)与绝缘体(insulator)之间的材料,常见的半导体材料有硅、砷化镓、氮化镓等
集成电路	指	英文"Integrated Circuit",一种微型电子器件或部件,是指采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连在一起,制作在半导体晶片或介质基片上,封装成具有所需电路功能的微型结构
微波集成电路	指	工作在微波波段和毫米波波段,由微波无源元件、有源器件、传输线和互联线集成在一个基片上,形成的具有某种功能的电路

第一节　本次非公开发行股票方案概要

一、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行背景

LED是一种半导体固体发光器件,具有节能、环保、寿命长等特点,无论从节约电能、降低温室气体排放的角度,还是从减少环境污染的角度,LED作为新型照明光源都具有替代传统照明光源的极大潜力,其广泛应用于背光源、显示屏、汽车市场以及交通信息、照明等领域。LED芯片行业属于朝阳产业,行业发展日新月异,十二五期间,我国LED产业规模年复合增长率将达到30%,其中LED外延片及芯片产业规模年复合增长率将达到68.41%,市场规模迅速扩大。因此公司必须顺应行业发展趋势,不断扩大业务规模,方可保持行业龙头地位。另外,随着市场竞争的日益激烈,未来产业内企业将面临洗牌,强者愈强、弱者越弱直至消灭的马太效应将充分显现。因此,为积极应对未来的市场竞争,在十二五期间实现新的跨越式发展,本公司需居安思危,把握当前全球LED产业发展的良好机遇,进一步加大投资力度,提升公司综合竞争实力,巩固和加强在国内LED行业的龙头地位,争取早日跻身世界LED行业前列。

随着第四代移动通信技术(4G)的引入,通讯领域对功率放大器在高功率传输上的应用要求越来越高。而传统硅制程由于存在低崩溃电压、高频损耗、讯号隔离度不佳、低输出功率等物理性特征,使其在功率放大器(PA)以及射频开关(RF Switch)的应用始终无法与砷化镓(GaAs)高速半导体器件匹敌。砷化镓(GaAs)功率放大器在高功率传输领域展现的优异的、不可替代的物理性能优势,使得砷化镓高速半导体器件产品越来越广泛应用于手机电话、无线局域网络、光纤通讯、卫星通讯、卫星定位、GPS汽车导航等领域。预计在未来较长的期间内,砷化镓高速半导体器件将在通讯市场占据重要地位。同时,氮化镓高功率半导体器件也开始应用于变频器、稳压器、变压器、无线充电等领域。由于氮化镓高功率半导体器件具有低导通损耗、高电流密度等优异的物理特性,使得通讯系统可显著减少电力损耗和散热负载,运作成本可以大幅降低。因此,砷化镓高速半导体器件和氮化镓高功率半导体器件在通讯领域应用前景非常广阔,是半导体行业需求的新蓝海。

(二)本次非公开发行目的

随着天津三安光电有限公司LED产业化项目、安徽三安光电有限公司芜湖光电产业化(一期)项目和厦门光电产业化(一期)项目的建设,公司已经确立了在LED行业的领先地位。通过本次非公开发行股票募集的资金,公司将应用部分资金实施厦门光电产业化(二期)项目。做大做强现有主业,进一步扩大在国内光电行业的产业布局,提高公司产品市场占有率,增强公司可持续发展的能力。

此外,公司虽然在国内半导体照明用外延片及芯片行业已经树立了领先的行业地位,但与国际半导体巨头相比,仍存在明显的差距,国际半导体巨头对照明用外延片及芯片核心技术垄断状况明显。而在通讯微电子领域,国际半导体巨头起步时间较晚,尚未形成明显的垄断地位。公司通过本次募投项目通讯微电子器件(一期)项目的实施可以迅速占据市场份额,缩小与国际半导体巨头的差距。

二、本次募集资金项目基本情况

(一)厦门光电产业化(二期)项目

1、募集资金使用计划及项目基本情况

本项目总投资为364,510万元,其中固定资产投资294,916万元,流动资金69,594万元;募集资金投入金额不超过230,000万元,全部用于本项目固定资产建设。本项目由子公司厦门三安光电有限公司实施,项目建成后将形成年产LED外延片122.3万片(该产能数据以4寸外延片计算)、芯片306.05亿粒的产能。

2、项目建设的必要性

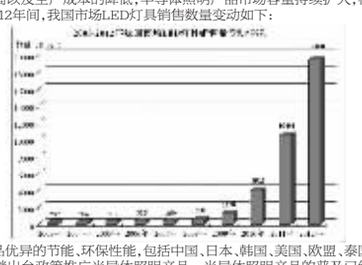
(1)顺应国家产业政策导向的需要

半导体照明产品具有优异的节能、环保性能,我国政府先后出台多项政策支持半导体照明产业发展:2003年6月,国家科技部就已将半导体照明工程产业纳入"863计划"重点专项;2006年2月,国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》将半导体照明产品明确列为"重点领域及优先主题",提出"重点研究高效节能、长寿命的半导体照明产品";2007年12月,国家发改委发布的《高新技术产业化"十一五"规划》将半导体照明器件列为高技术产业化重大专项;2009年10月,科技部、财政部、国家发改委等6部委联合发布《半导体照明节能产业发展意见》,提出继续加大半导体照明技术创新支持力度,积极实施促进半导体照明节能产业发展的鼓励政策;2011年12月,国务院发布的《工业转型升级规划(2011-2015)》提出应重点突破LED外延生长和芯片制造关键技术,提高外延片和高端芯片的国内保障水平;2012年7月,国家科技部发布的《关于印发半导体照明科技发展"十二五"专项规划的通知》提出,"十二五"期间,产业规模达到5000亿元,培育20-30家掌握核心技术、拥有较多自主知识产权、自主品牌的龙头企业,显著提升半导体照明产业的国际竞争力;2013年1月,国家发改委发布的《半导体照明节能产业规划》提出LED照明节能产业产值2015年达到4,500亿元;2014年6月,国务院发布的《国家集成电路产业发展推进纲要》提出增强芯片制造综合能力,以工艺能力提升带动设计水平的提升,以生产线建设带动关键装备和材料配套发展。

厦门三安光电有限公司本项目的实施顺应了国家半导体照明产业政策导向,完全符合国家对半导体照明产业的扶持政策及发展的实际需求。

(2)顺应行业发展趋势的需要

与白炽灯、荧光灯相比,半导体照明产品节能效果显著。在同样的照明效果下,半导体照明产品耗电是白炽灯的1/10、荧光灯的1/2,半导体照明产品寿命约为白炽灯的20-30倍、荧光灯的10倍。因此,半导体照明产品的普及和推广对于缓解当前的能源紧张及环境污染具有非常重要的意义。近年来,随着半导体照明质量和效率的提高以及生产成本的降低,半导体照明产品市场容量持续扩大,根据中国照明电器协会统计数据,2003-2012年间,我国市场LED灯具销售数量变动如下:



鉴于半导体照明产品优异的节能、环保性能,包括中国、日本、韩国、美国、欧盟、泰国、奥地利、中国台湾在内的国家和地区相继出台政策推广半导体照明产品,半导体照明产品的普及已经成为行业发展趋势,预计全球照明市场半导体照明产品市场规模、渗透率将不断提升,从而带动上游LED外延片、芯片行业产品需求的增长。

厦门三安光电有限公司本项目的实施顺应了半导体照明行业发展趋势,有利于公司把握半导体照明行业市场机遇,进一步提高产销量和盈利水平。

(3)保持和巩固公司行业龙头地位的需要

公司专业从事全色系超高亮度LED外延片及芯片的研发、设计、生产和销售以及LED应用产品的销售业务,目前公司在技术研发、工艺水平、生产规模、品牌、营销网络等方面形成了明显的竞争优势,并已成为全国LED芯片行业领导企业,LED外延片及芯片生产规模位居全国同行业第一。

通过本项目的实施,公司将实现高端LED外延片及芯片的扩产,有效突破高端LED外延片及芯片的产能瓶颈,有助于公司把握市场机遇,进一步提高市场占有率,巩固和强化行业龙头地位。

3、募集资金投资项目的市场前景

(1)半导体照明产品渗透率提升,带动上游外延片、芯片需求不断增长

鉴于半导体照明产品优异的节能、环保性能以及全球各国推广半导体照明产品政策的出台,推动照明市场半导体照明产品市场渗透率不断提升。

根据国家半导体照明工程研发及产业联盟统计数据,2014年全球照明产业已进入一个半导体照明领跑的时代,其中仅我国国内2014年度半导体照明产品产量就达到16.7亿支。预计2015-2020年间,全球照明市场半导体照明产品渗透率将不断增长,到2020年将达到65%-80%。随着全球照明市场规模的不断增长和半导体照明产品渗透率的不断提升,我国半导体照明产品市场容量将不断扩大,带动上游LED外延片、芯片需求的增长,为本项目产品销售带来良好的市场前景。

(2)深入挖掘现有客户需求,提高对现有客户的供货比例

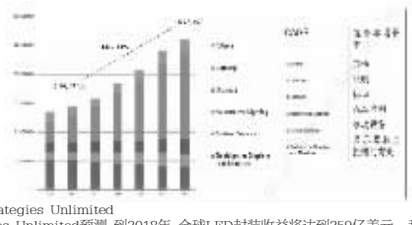
在与客户的长期合作过程中,公司产品所具备的规格齐全、质量优良、供货及时、服务完善等多方面的优势已为客户所广泛认同,现有的客户基础对公司开拓市场具有推进作用。本次募投项目投产后,公司将利用现有客户的市场平台进行业务拓展,深入挖掘现有客户需求,扩大对现有客户的供货量,提高供货比例。公司庞大的客户规模为募投产能的消化垫定了市场基础。

公司本项目产品的下游客户主要为封装客户和LED应用产品客户。

①LED封装市场规模快速增长,带动现有LED封装客户增量需求

近年来全球半导体封装产业整体规模不断增长,根据Strategies Unlimited统计数据,2014年全球LED封装收益超过150亿美元。预计2012-2018年间,全球LED封装收益年均复合增长率将达到13%,具体如下:

预计2012-2018年间全球LED封装收益变动情况



数据来源:Strategies Unlimited

根据Strategies Unlimited预测,到2018年,全球LED封装收益将达到259亿美元。我国市场作为全球最重要的半导体封装市场,半导体封装产业整体规模不断增长,根据国际半导体照明联盟(ISA)统计数据,2013年中国LED封装市场价值达到72亿美元,并将保持持续增长。国内LED封装应用厂家也都在筹划或实施扩产,特别是随着国星光电、雷曼光电、鸿利光电、勤上光电、瑞丰光电、万润科技等公司的相继扩产,可以预见其在新投建项目建成后产能大幅扩张,必然对芯片供应有更高的需求量。

LED封装市场容量的增长,将带动公司原有LED封装客户整体需求的增长,公司将深入挖掘现有LED封装客户的增量需求,提高供货比例。

②LED照明应用市场规模持续扩大,带动现有LED照明应用客户增量需求

目前,全球LED产业已经进入快速发展期,根据LED Inside统计,2012年全球LED照明市场规模达到104亿美元。其中,中国照明市场是仅次于欧洲市场的全球第二大照明市场,以中国市场为代表的新兴市场LED照明产品的普及将引领全球照明市场LED照明产品市场容量的增长。根据LED Inside预计,到2015年,全球LED照明市场区域份额情况如下:

2015年全球LED照明市场区域份额情况

资料来源:LED Inside

根据LED Inside预计,到2015年全球照明市场规模将达到821亿美元,其中LED照明市场规模将达到257亿美元,较2012年增长147%,LED市场渗透率将达到31%。

全球LED照明应用市场容量的持续增长,将带动公司原有LED照明应用客户整体需求的增长。公司销售团队将持续强化原有客户的维护与增量需求挖掘,保障本项目产能的顺利消化。

(3)持续开拓新市场、新客户,扩大产品销售的覆盖领域

在国内客户方面,近两年来公司已着手开发背光源、显示屏等行业领先的生产厂商(如背光源市场中的友达光电股份有限公司、显示屏市场的康佳、TCL、京东方等),并与其建立了紧密的业务联系。未来公司将进一步与国内汽车行业、电子电器行业、景观工程行业龙头企业接触,力争为其提供配套车用LED灯、数字计时指示灯和景观工程灯。公司将凭借已经建立的行业领先地位,深入开拓新应用市场、新客户,扩大国内市场产品的销售领域。

在国际客户方面,公司目前实际供货比例占下游客户需求量的比例依然很低,存在很大的市场开拓空间。随着公司LED外延片、芯片产品性能、技术水平的不断提升和国际市场对公司产品认可度的提升,中国周边的日本、韩国、我国台湾地区以及北美市场将成为公司进军国际市场的重要目标。公司也已通过一系列收购、合资、对外投资等措施,推动国际市场的开拓:2013年6月,公司收购美国流明(Luminus Devices, Inc.),推进公司国际化经营进程和北美市场的开拓;2014年8月,公司设立全资子公司—香港三安光电,有利于推进公司LED外延片、芯片产品在日本等国际市场开拓;2014年12月,公司与首尔半导体公司、首尔Viosys开展业务合作,合资成立三首光电,三首光电的成立有利于韩国LED市场开拓,加快了公司国际化发展步伐。公司国际化进程的推进,有利于国际市场新客户的开拓和销售市场覆盖范围的提升,带动本项目的产品实现顺利销售。

(4)多渠道进军LED封装、照明应用市场,促进公司芯片产能的自我消化

为顺应国家加快LED封装、照明应用产业化进程的产业政策导向,公司通过多种渠道进军LED封装、照明应用市场:

①公司与奇瑞控股有限公司在芜湖经济技术开发区合资成立芜湖安瑞光电有限公司,专门从事LED封装、应用,汽车照明灯具及其他应用领域各种相关零部件等产品的设计、生产、销售业务。根据奇瑞汽车公布的销量情况,2013年奇瑞汽车整车销量超过50万辆。以每部车使用3,000元LED车灯测算,奇瑞汽车对车用LED产品的年需求量约为15亿元。根据奇瑞汽车公告的未来发展目标,2015年以后公司整车年销量有望达到200万辆,从而将带动芜湖安瑞光电有限公司车用LED照明灯需求的增长。

②公司与浙江阳光照明电器集团股份有限公司(简称"阳光照明")在厦门市海沧区合资成立厦门阳光三安照明技术有限公司,从事LED照明产品的生产和销售。阳光照明作为上交所上市公司和中国LED照明行业的领先企业,在LED照明应用领域拥有广泛的客户群体和深厚的市场基础,本次合作有利于公司LED照明产品销售规模的扩大和市场占有率的提升。

③公司与深圳珈伟光伏照明股份有限公司(简称"珈伟光伏")在福建安溪合资成立福建珈伟光电有限公司,从事LED封装及下游LED路灯、LED球泡灯、LED射灯、LED工矿灯、LED新型室内外显示屏等产品的研发、生产和销售,双方约定在同等条件下,福建珈伟光电有限公司优先选用公司生产的LED芯片。本次合作有利于公司拓展LED产业链,并带动公司LED芯片产能的消化。

公司在LED封装和LED照明应用领域多渠道拓展,将提升公司LED芯片内部采购量,并为本次募投项目消化部分芯片产能。

(5)完善现有销售服务体系,提高客户服务水平

公司建立了完善的产品销售服务体系,在主要销售区域均设立了办事处,安排了专职市场服务人员实行24小时服务制,以解决产品使用中的技术问题和客户反馈。同时公司与客户建立了持续的交流沟通机制,实时跟踪客户需求和产品使用反馈,根据客户需求和反馈及时进行产品调整和跟进服务,提高服务水平和质量。

本项目投产后,公司将在现有销售区域办事处的基础上,扩大销售覆盖的市场范围,形成覆盖全国主要LED产业基地的营销服务网络,并不断强化国际营销团队建设,有步骤开拓国际市场。

综上所述,半导体照明产品市场渗透率的提升和LED封装、LED照明应用市场规模的不断增长,将带动上游LED外延片、芯片需求的增长,为行业带来广阔的市场空间;此外,公司在深入挖掘现有客户增量需求的基础上,稳步推进国际市场开拓进程,并多渠道进军LED封装、LED照明应用市场,持续扩大产品的市场占有率和市场覆盖范围,有助于带动本项目产品的市场需求,为本次募集资金投资项目新增产能消化提供充分的保障。

4、项目的选址

本项目位于厦门火炬(翔安)产业区下潭尾北部片区厦门三安光电产业化基地,本项目建设场址符合厦门市总体规划和翔安区规划,也符合通讯微电子行业生产的选址要求。

厦门位于福建东南沿海,是一座重要的港口城市,也是闽南金三角的中心,有4条铁路、2条国道在此交汇。厦门市翔安区地处海峡西岸经济区最前沿,居厦、漳、泉"金三角"核心地带,下潭尾北片区是厦门市翔安区重要的电子信息产业、物流仓储及生活配套综合区,产业集聚优势及区位优势明显。

5、项目实施进度安排

本项目由厦门三安光电负责实施,项目建设期为24个月。

6、项目效益预测

本项目建设期为24个月,预计达产年销售收入317,424万元(不含税),达产年税后净利润66,468万元。

7、项目备案及环评情况

本项目已完成备案,环评手续正在办理过程中。

(二)通讯微电子器件(一期)项目

1、募集资金使用计划及项目基本情况

本项目总投资300,475万元,其中固定资产投资243,213万元,流动资金57,262万元,其中使用募集资金投入不超过160,000万元,全部用于本项目固定资产建设。本项目由公司子公司厦门市三安集成电路有限公司实施,项目建成后将形成通讯用外延片36万片/年(以6吋计算)、通讯用芯片36万片/年(以6吋计算)的产能。

2、项目建设的必要性

(1)顺应行业发展趋势的需要

随着第四代移动通信技术(4G)的引入,通讯领域对功率放大器在高功率传输上的应用要求越来越高。而传统硅制程由于存在低崩溃电压、高频损耗、讯号隔离度不佳、低输出功率等物理性特征,使其在功率放大器(PA)以及射频开关(RF Switch)的应用始终无法与砷化镓(GaAs)高速半导体器件匹敌。砷化镓(GaAs)功率放大器在高功率传输领域展现的优异的、不可替代的物理性能优势,使得砷化镓高速半导体器件产品越来越广泛应用于手机电话、无线局域网络、光纤通讯、卫星通讯、卫星定位、GPS汽车导航等领域。预计在未来较长的期间内,砷化镓高速半导体器件将在通讯市场占据重要地位。同时,氮化镓高功率半导体器件也开始应用于变频器、稳压器、变压器、无线充电等领域。由于氮化镓高功率半导体器件具有低导通损耗、高电流密度等优异的物理特性,使得通讯系统可显著减少电力损耗和散热负载,运作成本可以大幅降低。

因此,砷化镓高速半导体器件和氮化镓高功率半导体器件在通讯领域应用前景非常广阔,是半导体行业需求的新蓝海。公司本项目的实施是顺应行业发展趋势的需要。

(2)顺应国家产业政策导向的需要

2014年6月24日,国务院发布《国家集成电路产业发展推进纲要》(简称"《纲要》"),《纲要》指出集成电路产业是信息技术产业的核心,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业,当前和今后一段时期是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期和攻坚期。《纲要》将集成电路产业确定为国家的战略性产业,并提升到了前所未有的战略高度。

《纲要》提出要加快发展集成电路制造业,抓住技术变革的有利时机,突破投融资瓶颈,加快芯片产能扩充和立体工艺开发,形成规模化生产能力,增强芯片制造综合能力,以工艺能力提升带动设计水平提升,以生产线建设带动关键装备和材料配套发展。

厦门市三安集成电路有限公司的成立和本次募投项目的设计,顺应了国家集成电路产业政策导向,完全符合国家对集成电路产业的扶持政策及产业发展的实际需求。

(3)企业自身发展战略的需要

公司是我国光电子显示及芯片生产的龙头企业,在外延片、芯片研发领域具有雄厚的技术研发实力。公司外延片及芯片产量、销量规模位居全国第一,形成了扎实的外延片及芯片规模化生产能力。

公司虽然在国内半导体照明用外延片及芯片行业已经树立了领先的行业地位,但与国际半导体巨头相比,仍存在明显的差距,国际半导体巨头对照明用外延片及芯片核心技术垄断状况明显。但在通讯微电子领域,国际半导体巨头起步时间较晚,尚未形成明显的垄断地位。公司通过本次募投项目的实施可以迅速占据市场份额,缩小与国际半导体巨头的差距。但通讯微电子产品的投产,前期需要大规模的设备和资金投入,公司拟通过本次非公开发行融资为本项目的实施提供资金支持。

3、募集资金投资项目的市场前景

(1)智能手机市场容量巨大,摆脱"国际芯片税"指日可待

根据专业研究机构TrendForce最新统计数据,2014年度全球智能手机出货量达到11.67亿部,较2013年增长25.9%。其中,中国智能手机出货量达到4.53亿部,贡献了全球近40%的份额。2013年以来中国智能手机市场中,4G手机的占比急剧增长,根据TrendForce统计,2014年度,中国智能手机市场4G手机出货量达到1.71亿部(占比达到38%),并将在未来5年内实现高速增长,中国大陆移动通信正式进入4G时代,4G智能手机的市场容量巨大。

目前,4G的射频通信普遍使用5模13频的砷化镓前端放大器模块(所谓5模,就是指单个芯片同时支持TD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA、GSM五种不同的通信模式),多模多频的砷化镓/氮化镓前端放大器模块是保证4G通信质量的核心射频器件。目前,单部4G智能手机仅达到标准的通信效果,就至少需要5颗以上的砷化镓/氮化镓功率放大器,此外智能手机中的卫星定位功能也需要用到1颗功率放大器,4G智能手机支持的无线局域网通信(WLAN)也需要至少1颗功率放大器。

因此,粗略估计,2014年度国内4G智能手机耗用的砷化镓/氮化镓功率放大器超过12亿颗。而我国智能手机用砷化镓/氮化镓芯片90%以上依赖进口,特别是4G智能手机所用的芯片几乎全部依赖进口(根据中国通信工业协会统计,国内一线、二线智能手机品牌几乎100%应用进口芯片)。我国智能手机用进口砷化镓/氮化镓芯片的最主要来源为美国高通公司(Qualcomm),2014年度美国高通公司在中国市场的销售收入为129亿美元,占其全球总收入的近50%。

国内智能手机生产厂商除了要向以美国高通公司为代表的国际半导体巨头支付高额的芯片采购费用外,还要按手机零售价的一定比例(比如高通公司收取5-6%)收取专利授权费。因此,以美国高通公司为代表的国际半导体巨头被国内通讯业界称为"中国的芯片税务局"。

为扭转当前国内高端电路产业(特别是砷化镓高速半导体、氮化镓高功率半导体)受制于国际半导体巨头的被动局面,国务院2014年发布《国家集成电路产业发展推进纲要》,将集成电路产业确定为国家的战略性产业,并大力扶持国内集成电路产业发展,以求摆脱微纳"国际芯片税"的局面。公司未来将显著受益于国家产业政策:一方面,公司作为国内外延片、芯片龙头企业,将成为国家产业政策扶持的重点企业;另一方面,公司具有明显的规模经济优势,公司生产的砷化镓高速半导体、氮化镓高功率半导体与国际半导体巨头相比具有明显的成本优势,在国内智能手机市场竞争优势较强。

因此,公司本项目生产的砷化镓高速半导体器件、氮化镓高功率半导体器件在国内智能手机市场潜在需求巨大。

(2)砷化镓/氮化镓半导体器件在光纤通讯市场容量持续扩大

光纤通讯领域是砷化镓/氮化镓半导体器件的另一个重要应用领域。砷化镓/氮化镓半导体器件作为光纤收发器、光纤转发器的重要部件,其应用与光纤通讯领域的发展息息相关。光纤通讯由于具有高速、大容量、保密性好、不受干扰、省电等多方面的优势,使得其在移动互联网领域的重要性日益提升,使用范围和市场容量不断扩大。

2013年以来,移动通信与固定宽频融合成移动互联网的趋势越发明显,移动互联网平台已初具规模。根据国家工信部统计数据,截至2014年底,中国移动互联网用户达到8.75亿户,并且持续增长。

移动互联网用户的增长带动了光纤通讯产品的需求的增长,并间接带动了砷化镓/氮化镓半导体器件在光纤通讯领域需求的增长。Infonetics Research最新市场研究报告指出2014全年10G/40G/100G光模块市场规模达到21亿美元,较2013年增长10%。Infonetics Research预测到2016年,全球10G/40G/100G光纤收发器和转发器市场规模将达到28亿美元,年均复合增长率超过15%。光纤收发器和转发器规模的增长将带动核心配件—砷化镓/氮化镓半导体器件需求的增长。

(3)砷化镓/氮化镓半导体器件在汽车电子、卫星导航、军事通信市场应用前景广阔

除智能手机、光纤通讯领域的应用外,近年来砷化镓/氮化镓半导体器件在汽车电子、卫星导航、军事通信领域的应用也不断增长:第一,新出厂的车辆为结合物联网提高行车安全性,将提升车载电子的比率,其中包括M2M通信、前后方防撞雷达等均与砷化镓/氮化镓产业相关;第二,卫星导航已成为汽车的标准配备,我国政府也在积极构建北斗系统以用于民用导航,而砷化镓半导体器件是卫星通讯用波段频率的最佳选择;第三,随着我国军事实力的增强,军事通讯领域高端通讯产品的应用市场也不断增长,为我国砷化镓/氮化镓产业的发展带来了机遇。

因此,公司本项目生产的砷化镓/氮化镓半导体器件应用范围广阔,市场容量不断增长,产能消化前景良好。

(4)立足国内市场,并择机开拓国际市场

公司本项目砷化镓高速半导体器件与氮化镓高功率半导体器件的销售将首先立足国内市场,深入挖掘国内通信器件设计公司、智能手机生产厂商、光纤通讯设备公司、汽车生产厂商的需求,并把握时机开拓卫星通讯及军用市场,不断扩大市场销售的覆盖度。

在深挖国内市场的同时,公司将择机开拓国际市场,与国际半导体巨头相比,公司产品明显的成本优势将为该项目砷化镓/氮化镓半导体器件的国际市场开拓奠定较好的基础。

4、项目的选址

本项目位于厦门火炬(翔安)产业区下潭尾北部三安集成电路产业化基地内,建设场址符合厦门市总体规划和翔安区规划,也符合通讯微电子行业生产的选址要求。

厦门位于福建东南沿海,是一座重要的港口城市,也是闽南金三角的中心,有4条铁路、2条国道在此交汇。厦门市翔安区地处海峡西岸经济区最前沿,居厦、漳、泉"金三角"核心地带,下潭尾北片区是厦门市翔安区重要的电子信息产业、物流仓储及生活配套综合区,产业集聚优势及区位优势明显。

5、项目实施进度安排

本项目建设期为合计3年零9个月(合计45个月)。

6、项目效益预测

本项目建设期为45个月,预计达产年销售收入401,539万元(不含税),新增年净利润59,624万元。

7、项目备案及环评情况

本项目的已经取得厦门市火炬高新区管委会厦高管【2014】94号文备案,环评手续正在办理过程中。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

1、本次发行对公司经营管理的影响

本次非公开发行后,有利于扩大公司生产规模,提高公司产品市场占有率,增强公司可持续发展的能力。

2、本次发行对公司财务状况的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益,项目完成后,能够进一步提升公司的盈利水平,增加利润增长点,减少财务费用,增强竞争能力,募集资金的用途合理、可行,符合公司及全体股东的利益。

本次非公开发行完成后,公司资本实力大大增强,净资产将大幅提高,同时公司资产负债率也将有一定幅度的下降,有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

四、结论

综上,经审慎分析论证,董事会认为:公司本次非公开发行的募集资金投向符合国家产业政策和公司发展的需要,投资项目具有较强的盈利能力和良好的市场前景。通过本次募集资金投资项目的实施,将进一步扩大公司业务规模,增强公司的综合竞争力和抗风险能力,促进公司的可持续发展,符合公司及全体股东的利益。本次募集资金投资项目是必要且可行的。

第四节　董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析

一、本次发行对公司业务,公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响

(一)公司主营业务为LED产品的研发、生产和销售,主要产品为砷化镓系列、氮化镓系列外延片、芯片以及LED应用产品。本次非公开发行募集资金投资建设的项目为公司的主营业务,本次发行完成后,公司主营业务不会发生变化。

(二)本次发行后,《公司章程》除对公司注册资本与股本结构进行调整外,暂无其他调整计划。公司将继续执行原有的战略及经营计划,不会因本次发行而发生改变。

(三)公司本次发行完成后,大股东三安电子对公司的持股比例有所下降,但实际控制人林秀成通过三安电子以及三安集团对公司仍处于控股地位。本次非公开发行不会导致公司控股权的变化,随着新股东的引入,有利于公司治理结构的优化。

(四)本次发行后,公司高管人员结构不会发生变化。

(五)本次发行后,将增强公司资本实力。随着募集资金的投入和项目的实施,将进一步提升公司的盈利能力,业务结构不会发生重大变化。

二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

本次发行对公司财务状况将带来积极影响,充实公司的股权资本,优化公司的资本结构,公司的总资产和净资产将大幅增加,公司的资产负债率将有所下降,有效降低了公司的财务风险,偿债能力得到进一步提高,并增强公司长期盈利能力。

1、财务状况的变动

本次发行后,公司的资产规模大幅增加,资产负债率将有效下降。同时由于募集资金投资项目效益良好,公司财务状况将得到较大改善,盈利能力进一步提高,整体实力和抗风险能力得到显著增强。

2、盈利能力的变动

募集资金投资项目短期内属于建设期,不会产生效益,公司在发行后净资产收益率将有所摊薄。

随着公司募投项目的实施,公司在半导体行业、领域的生产、研发实力将得到增强,项目利润不断增加,公司长期盈利能力将会有大幅提高,更有利于为股东创造更多回报。

3、现金流量的变动

在本次募集资金到位后,公司筹资活动现金流入量将大幅提高;募集资金投入使用后,投资过程中现金流出量也将大幅提高。随着项目的实施,投资项目带来的现金净流量逐年体现,公司的资金状况将得到改善。

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行后,公司与大股东及关联人之间的业务关系、管理关系均未发生变化,不产生同业竞争和关联交易。

四、本次发行完成后,公司不存在资金、资产被大股东及关联人占用的情形,或公司为大股东及关联人提供担保的情形

截至本次非公开发行预案公告日,本公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,也不存在公司为大股东及其关联人提供担保的情形。公司不会因为此次发行发生资金、资产被大股东及其关联人占用的情形,也不会产生为大股东及其关联人提供担保的情形。

五、本次非公开发行对公司负债情况的影响

本次发行募集资金到位后,降低公司资产负债率,提高公司偿债能力,增强公司抗风险能力,同时,也有助于提升公司融资的空间和能力,为募集资金投资项目的实施和公司未来业务的发展提供有力保障。

六、本次股票发行相关的风险说明

投资者在评价公司本次非公开发行股票时,除预案提供的其他各项资料外,应特别认真考虑下述各项风险因素:

1、行业竞争加剧的市场风险

尽管我国LED产业已初步形成了包括外延片生产、芯片制造、芯片封装以及LED产品应用在内的较为完整的产业链,但产业链各环节的发展比较不均衡。

LED产品生产企业大都集中在产业链中下游的封装、